

レーザはんだ付け装置 仕様紹介

1. 設備概要 はんだ接続するワークをセットした治具をステージ上にセット後、作業者が安全扉を手動で閉じて、事前に作成されたパラメータ（ステージ位置データとはんだ付け条件）に基づき、加工部へ移動して、はんだ供給・レーザ照射を実施して、はんだ付けを半自動で行う設備です。

2. 設備仕様

①設備全体

設備寸法	横幅：604mm 奥行：935mm（操作BOX含む） 高さ：730mm（パトライト含まず）		
安全扉	横幅：544mm 縦幅：250mm（ダンパー式扉開閉）		
治具セット位置	高さ：135mm 奥行：250mm（設備前面から治具中央）		
スタートスイッチ	1点押しスタートスイッチ		
重量	約80kg		
ユーティリティ	電源：単相100V 供給エアなし		
ヒューム排気	設備上方にダクト接続用フランジ設置可能な事（集塵設備は含まれておりません。）		

②ステージ仕様

	駆動範囲	分解能	繰り返し精度
X軸（左右）	±100mm	0.02mm/p	±0.02mm
Y軸（前後）	±100mm	0.02mm/p	±0.02mm
Z軸（上下）	±50mm	0.02mm/p	±0.02mm

③制御

P C制御	デスクトップ型（DIOボードを拡張） 各ユニットとの接続 ※表示は日本語表記。
液晶モニター	21.5インチワイド液晶
操作パネル	3.5インチ タッチパネル（レーザ制御用）

④半田付け機

方式	L D（空冷）
LD照射角度	-45度～45度（ヘッド部の取付位置の変更による角度調整が可能で取付位置は7か所）
LD制御	出力・時間

※出力・波長・WD・スポット径は使用機種によります。

⑤半田供給

角度	微調整が可能（手動）
回転	微調整が可能（手動）
制御	半田供給機とLDをPC経由にて制御を行いますので同期運転が出来ます。 送り速度・時間・LD ON/OFF・戻速度・時間のタイミング設定が行えます。

⑥半田治具

治具寸法	200mm×200mm ただし基板搭載可能サイズは、200mm×155mm
治具固定	位置決めピン付きプレートで治具固定可能な機構とします。

⑦加工観察

レーザと同軸で加工中の観察が可能なカメラ、光源、モニターを装備しています。（レーザ照射時は観察不可）

3. 制御ソフトウェア

操作及びデータ入力・編集は、マウス及びキーボードで行います。

- ①品種登録 品種登録と実行が可能です。（ポイント数/品種については御相談）
- ②パラメータ作成 ティーチング画面で各ポイントの位置合わせとレーザ照射で1ポイント毎の確認が可能です。
手動操作のステップ送りで作成された各ポイントのパラメータの動作確認が可能です。
- ③自動運転 スタートボタンで自動実行が可能です。
- ④モニター画面 I/Oの状況確認が可能です。
- ⑤接続設定画面 各ユニットとの接続状態の確認が可能です。

装置はお客様のご要望に応じて、装置サイズ、各種機器、その他仕様の変更が可能です。

お問い合わせは

オー・エム・シー株式会社

〒569-1026 大阪府高槻市緑が丘2丁目3-12

電話: 072-688-8331 FAX: 072-688-8332

Web Site: <http://www.jomc.co.jp>